

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年11月2日(2006.11.2)

【公開番号】特開2004-146808(P2004-146808A)

【公開日】平成16年5月20日(2004.5.20)

【年通号数】公開・登録公報2004-019

【出願番号】特願2003-324962(P2003-324962)

【国際特許分類】

H 01 L 23/29 (2006.01)

H 01 L 23/31 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/30 R

【手続補正書】

【提出日】平成18年9月13日(2006.9.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に形成された回路素子を含むデバイスチップと、
前記デバイスチップの少なくとも一部分を覆うキャップと、
前記キャップを前記デバイスチップへと封止するガスケットであつて、前記デバイスチップとの接合部に隆起パターンを設けた面を持つガスケットと
を具備することを特徴とする封止装置。

【請求項2】

前記隆起パターンを設けた面が、谷部分を含むものであることを特徴とする請求項1に記載の封止装置。

【請求項3】

前記デバイスチップが、前記ガスケットをその上に取り付けるための接着剤を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の封止装置。

【請求項4】

前記キャップが前記デバイスチップへ冷間溶接により接合されることを特徴とする請求項1又は2に記載の封止装置。

【請求項5】

冷間溶接用メタルとして、金が用いられることを特徴とする請求項4に記載の封止装置。

【請求項6】

前記キャップが前記回路素子を気密封止するものであることを特徴とする請求項1、3又は4に記載の封止装置。

【請求項7】

前記ガスケットが、4~30ミクロンの範囲の幅を持つことを特徴とする請求項1、3又は4に記載の封止装置。

【請求項8】

前記ガスケットが、5~50ミクロンの範囲の厚さを持つことを特徴とする請求項1、3又は4に記載の封止装置。

【請求項9】

前記隆起パターンが、1～5ミクロンの範囲の幅を持つことを特徴とする請求項1、3又は4に記載の封止装置。

【請求項10】

前記隆起パターンで谷部分が画定され、前記谷部分のそれぞれが1～3ミクロンの範囲の深さを持つことを特徴とする請求項1、3又は4に記載の封止装置。